

**JPCA** 50th Anniversary  
**Show**

第50回国際電子回路産業展

**JIEP** マイクロエレクトロニクスショー

第35回 最先端実装技術・パッケージング展

**実装関連展**



**有機デバイス総合展**

IoT 対応半導体・回路基板展



**WIRE Japan Show**

電気・光伝送技術展

**JEP/TEP Show**

JEP 全国電子部品流通連合会  
東京都電機卸商業協同組合



**E-Textile**

イーテキスタイル展

**Smart Sensing**

スマートセンシング

INTERNATIONAL OPTOELECTRONICS EXHIBITION

**InterOpto**

インターオプト

**LED JAPAN**

エルイーディージャパン

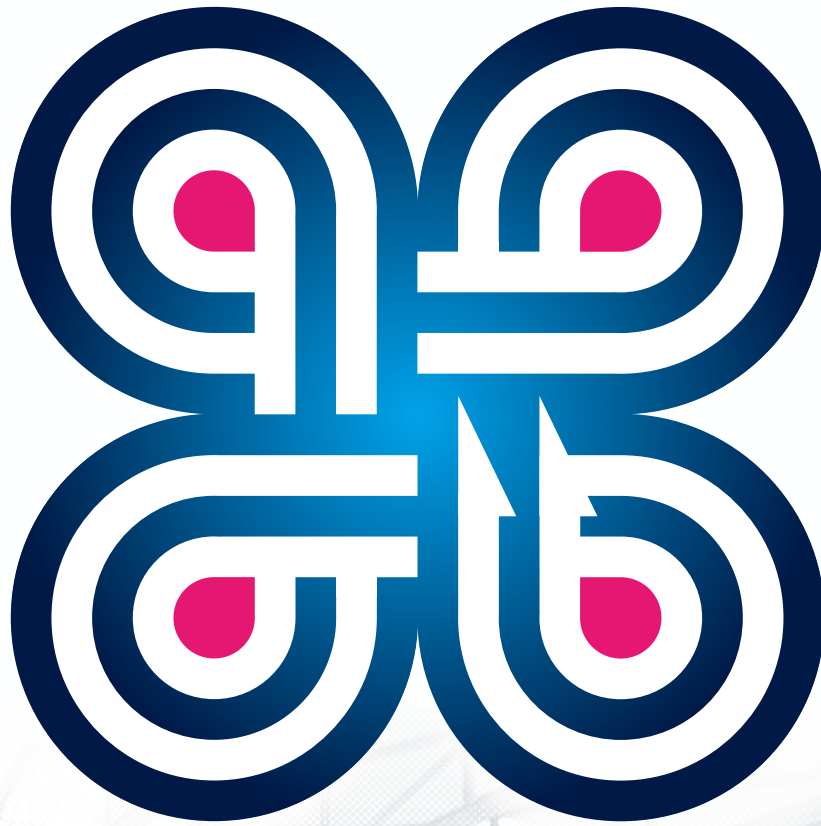
**Imaging Japan**

イメージングジャパン

**Edge Computing**

エッジコンピューティング

来て 見て 触れて そして 語ろう!



出展の  
ご案内

2021.10.27 Wed. → 10.29 Fri.

東京ビッグサイト 南1-3ホールで開催いたします。

5G、自動車、IoT、ロボット、ウェアラブル等を具現化する技術の総合展示会

**電子機器2021**  
トータルソリューション展

[www.jpcaashow.com](http://www.jpcaashow.com)



展示会公式サイトへ

主催：一般社団法人日本電子回路工業会、一般社団法人エレクトロニクス実装学会、  
共催：電子デバイス産業新聞【(株)産業タイムズ社】、電線新聞【(株)工業通信】、  
(株)JTBコミュニケーションデザイン、  
全国電子部品流通連合会 / 東京都電機卸商業協同組合  
福井県e-テキスタイル製品開発研究会、一般財団法人光産業技術振興協会  
後援(予定)：経済産業省

海外協力：世界電子回路業界団体協議会 (WECC) 加盟団体  
中国電子回路行業協会 (CPCA)、欧州電子回路協会 (EIPC)、印度電子工業会 (ELCINA)、  
香港線路板協会 (HKPCA)、米国電子回路協会 (IPC)、印度電子回路工業会 (IPCA)、  
韓国電子回路産業協会 (KPCA)、タイ電子回路工業会 (THPCA)、  
台湾電路板協会 (TPCA)

# 5G、自動車、IoT、ロボット、ウェアラブル、 最先端光学システム等を具現化する技術の総合展示会

エレクトロニクス展示会の中でも専門性・注目度が高く、広く国内外からも多くの来場者を迎え、  
活発な商談の場としてご利用いただいています。

## 開催概要

目的	あらゆる電子・情報通信・制御機器に使用される電子回路・実装技術や、用途の広がりを見せるセンサー・E-Textile (ウェアラブル技術)等の新しいコンテンツとソリューション等の展示を加え、技術情報の提供・提案をはかり、併せて電子回路業界及び関連業界全体の発展に寄与する。
会期	2021年10月27日(水)~29日(金) 午前10時~午後5時
会場	東京ビッグサイト 南1-3ホール
本部事務局	一般社団法人 日本電子回路工業会 (JPCA)
運営事務局	株式会社 JTBコミュニケーションデザイン
入場料	1,000円(税込) ※WEB登録で無料

## 2019年開催実績

会場	東京ビッグサイト 西ホール+会議棟	来場者数	44,110名
出展規模	507社 / 1,372小間	セミナー聴講数	11,421名

## 2021年展、3つのポイント!

① 12展示会を2年ぶりに同時開催!  
新たに4展示会を加え、  
より広範なテーマで展示会を盛り上げます。



② セミナーの活用  
基調講演など100本を超える  
セミナーを実施!!



③ 新たな来場動員施策

国内外の団体・協会等との連携により、**新たな来場者層からの動員を計画**。  
また、**スタンプラリー、来場者抽選会等を企画**し、より多くの出展企業ブースを  
ご訪問頂く施策も実施します。

# ■ 構成展示会・出展対象

<p style="text-align: center;"><b>電子回路技術</b></p> <p style="text-align: center;"><b>JPCA Show</b> 50th Anniversary</p> <p style="text-align: center;"><b>第50回国際電子回路産業展</b></p> <p>●プリント配線板技術展 製品(電子回路基板等の電子機器)、設計技術、信頼性/検査技術、主材料/絶縁材料、機能材料/プロセス材料/資機材、製造装置/設備、環境システム、物流システム</p> <p>●半導体パッケージング・部品内蔵技術展 モジュール基板/モジュール基板実装/部品内蔵に関する技術全般(製品/関連製品/設計/信頼性検査/材料・機能材料/関連装置/関連システム等)</p> <p>●フレキシブルプリント配線板製品出展エリア フレキシブルプリント配線板に関する技術全般(製造/関連製品/設計/信頼性検査/材料・機能材料/関連装置/関連システム等)</p> <p>●機器・半導体受託生産システム展 EMS等の電子電気機器及び半導体に関する受託サービス全般(製造/関連製品/設計/信頼性検査/材料・機能材料/関連装置/関連システム等)</p> <p>主催：一般社団法人日本電子回路工業会</p>	<p style="text-align: center;"><b>高密度実装技術</b></p> <p style="text-align: center;"><b>JIEP</b> マイクロエレクトロニクスショー</p> <p style="text-align: center;"><b>第35回 最先端実装技術・パッケージング展</b></p> <p>実装・電子技術に関する技術全般(材料/回路・実装設計/高速高周波/電磁特性/電子部品・実装/光回路実装/環境調和型実装/半導体パッケージ/マイクロメカトロニクス実装技術/各種関連製造装置等)</p> <p>主催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会</p>	<p style="text-align: center;"><b>電子部品実装技術</b></p> <p style="text-align: center;"><b>実装関連展</b></p> <p>電子部品実装に関する技術全般(電子部品実装機・システム/半導体実装機器・システム/検査技術・システム/実装設計システム/各種ロボット等)</p> <p>主催：一般社団法人日本電子回路工業会</p>
---	--	--

<p style="text-align: center;"><b>新規回路形成技術</b></p> <p style="text-align: center;"><b>有機デバイス総合展</b></p> <p style="text-align: center;">IoT対応半導体・回路基板展</p> <p>有機デバイスに関する技術全般(プリンテッドエレクトロニクス製品・部品/MEMS/センサーLED/OLED/有機半導体関連応用製品/設計/信頼性検査/材料・機能材料/関連装置/関連システム等)</p> <p>共催：一般社団法人日本電子回路工業会 電子デバイス産業新聞((株)産業タイムズ社)</p>	<p style="text-align: center;"><b>電気・光伝送技術</b></p> <p style="text-align: center;"><b>WIRE Japan Show</b></p> <p style="text-align: center;">電気・光伝送技術展</p> <p>ワイヤー・ケーブル等を用いる伝送技術全般(産業用機器/電線・ケーブル及びコネクタ/電線加工機/配線用部材/ワイヤーハーネス/電線・ケーブル用計測器/各種装置/検査技術/装置間(M2M)伝送/光伝送等)</p> <p>共催：一般社団法人日本電子回路工業会 電線新聞((株)工業通信)</p>	<p style="text-align: center;"><b>半導体・電子部品</b></p> <p style="text-align: center;"><b>JEP/TEP Show</b></p> <p style="text-align: center;">JEP 全国電子部品流通連合会 東京首都電機卸商業協同組合</p> <p>半導体・電子部品等を用いたソリューション技術全般(半導体/電子デバイス/センサー/機構部品/FA制御機器/計測器/電源/IoT・M2Mソリューション/もの作りソリューション・システム等)</p> <p>共催：一般社団法人日本電子回路工業会 全国電子部品流通連合会 東京首都電機卸商業協同組合</p>	<p style="text-align: center;"><b>高機能テキスタイル</b></p> <p style="text-align: center;"><b>E-Textile</b></p> <p style="text-align: center;">イーテキスタイル展</p> <p>電子技術と繊維・衣料が融合するイーテキスタイル(スマートテキスタイル/ストレッチャブル技術/ウェアラブル技術)に関する技術全般(繊維素材・材料/導電性素材・材料/編・織技術/プリント・マーキング技術/フィルム/センサー/信頼性検査/関連装置・システム等)</p> <p>共催：一般社団法人日本電子回路工業会 福井県e-テキスタイル製品開発研究会</p>
--	---	---	--

<p style="text-align: center;"><b>センサー技術</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Smart Sensing</b></p> <p style="text-align: center;">スマートセンシング</p> <p>センサー及びセンシングシステムに関する技術全般(センサー/センサーノード関連、半導体/部品デバイス、電子機器、通信デバイス/ネットワークシステム、ソフトウェア関連、データプラットフォーム、電源、その他周辺機器/技術/サービス)</p> <p>共催：一般社団法人日本電子回路工業会 株式会社JTBコミュニケーションデザイン</p>	<p style="text-align: center;"><b>New!</b> エッジソリューション技術</p> <p style="text-align: center;"><b>Edge Computing</b></p> <p style="text-align: center;">エッジコンピューティング</p> <p>低遅延、高安全、低通信量などの優位性をもつエッジソリューション全般 [エッジソリューション応用分野]自動運転システム/工場内機械制御/遠隔医療/AR/VR/スマートシティ/アグリテック/FinTech/無人店舗 等</p> <p>共催：一般社団法人日本電子回路工業会 株式会社JTBコミュニケーションデザイン</p>	<p style="text-align: center;"><b>New!</b> All about Photonics</p> <p style="text-align: center;"><b>光&amp;次世代アプリケーション・ネットワークシステム</b></p> <p style="text-align: center;">INTERNATIONAL OPTOELECTRONICS EXHIBITION <b>InterOpto</b> インターオプト</p> <p>レーザー・光源(半導体、ファイバ、超短パルス)/光素子・部品(レンズ/フィルタ、ガラス、光スキャナ)/測定装置・光分析機器/生産向けレーザーシステム(レーザー加工装置、マーキング装置)/光情報通信(可視光通信、5G)</p> <p>主催：一般財団法人光産業技術振興協会 企画・推進：株式会社JTBコミュニケーションデザイン</p>		<p style="text-align: center;"><b>深紫外・近赤外・LED 応用開発</b></p> <p style="text-align: center;"><b>LED JAPAN</b></p> <p style="text-align: center;">エルイーディージャパン</p> <p>紫外・近赤外LED/LEDパッケージ部品/デバイス・電源/測定・検査・製造装置/光学部品・材料/LED応用最終製品(車載照明、LED可視光通信、医療用照明)</p> <p>共催：一般社団法人日本電子回路工業会 株式会社JTBコミュニケーションデザイン</p>
			<p style="text-align: center;"><b>画像処理・センシング技術</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Imaging Japan</b></p> <p style="text-align: center;">イメージングジャパン</p> <p>各種カメラ・センサ機器/画像処理機器/画像認識・画像理解技術/計測・測定技術/LiDAR</p> <p>共催：一般社団法人日本電子回路工業会 株式会社JTBコミュニケーションデザイン</p>	

# ■ 各分野における想定される来場企業

## ● All about Photonics を迎え、新たな顧客層が広がります。

- **自動車関連** アイシン精機、朝日電装、市光工業、カルソニックカンセイ、ケーヒン、KOA、小糸製作所、スタンレー電気、住友電装、ダイハツ工業、デンソー、東海理化、東洋電装、トヨタ自動車、日産自動車、日本発条、パイオニア、日立オートモティブシステムズ、日野自動車、SUBARU、本田技研工業、マツダ、三菱自動車工業、矢崎部品
- **OA・ロボティクス** オムロン、キーエンス、キャノン、コニカミノルタ、サイバーダイン、山洋電気、JUKI、セイコーエプソン、パナソニック、パナソニックスマートファクトリーソリューションズ、ファナック、FUJI、富士ゼロックス、三菱電機、安川電機、ヤマハ発動機、リコーインダストリー、リコージャパン
- **情報・通信関連** アップル、インテル、NHKメディアテクノロジー、NTT、NTTドコモ、沖電気工業、韓国放送公社(KBS)、京セラ、KDDI、ソフトバンク、東京放送ホールディングス(TBS)、東芝情報システム、日本IBM、日本電気、日本マイクロソフト、日本ユニシス、パナソニック、PFU、日立製作所、Huawei、フジクラ、富士通、村田製作所
- **A・V・家電関連** LGエレクトロニクス、カシオ計算機、キャノン、Samsung Electronics、シャープ、ソニー、ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ、ソニーセミコンダクタソリューションズ、ダイキン工業、ニコン、パイオニア、パナソニック、富士通ゼネラル、ヤマハ、ローランド
- **医療機器関連** オリンパス、Siemens、島津製作所、白河オリンパス、テルモ、東芝メディカルシステムズ、日立ハイテクノロジーズ、日立ヘルスケア・マニュファクチャリング、富士フイルム、マーク電子、モリタ東京製作所
- **半導体デバイス関連** インテル、STマイクロエレクトロニクス、キャノン、サムスン電子、SCREENホールディングス、ソニー、TDK、東京エレクトロン、東芝メモリ、ニコン、日立ハイテクノロジーズ、富士通セミコンダクター、マイクロンジャパン、ルネサスエレクトロニクス、ローム
- **航空・宇宙関連** IHI、NECスペーステクノロジー、JAXA(宇宙航空研究開発機構)、シンフォニアテクノロジー、ナブテスコ、日本アビオニクス、日本電気、三菱重工業、三菱電機
- **光技術** 大日本印刷、凸版印刷、HOYA、浜松ホトニクス、住友電気工業、横河電機、LIXIL、アズビル、NGKエレクトロデバイス、NTTエレクトロニクス、加賀電子、JVCケンウッド、日本HP、IHI検査計測、ディスコ、アルプスアルパイン、キャノンメディカルシステムズ、ソニーIP&S、積水化学工業、シグマ光機、シャープ福山レーザ、日本ガイシ、日本板硝子
- **その他** 海上自衛隊、陸上自衛隊、東京ガス、東京電力ホールディングス、東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道、東日本旅客鉄道
- **電子回路基板** アドバンテスト、イースタン、イビデン、エルナー、協栄産業、京写、京セラ、キョウデン、シライ電子工業、伸光製作所、新光電気工業、住友電工プリントサーキット、大昌電子、日東電工、日本シイエムケイ、日本メクトロン、パナソニック、日立化成、フジクラ、富士通インターコネクトテクノロジーズ、メイコー、山下マテリアル、利昌工業

## ■ 出展料金

区分	1小間 / 9m <sup>2</sup>	
一般	451,000円 (税込)	
一般早期*1 ※一部適用外があります。	419,100円 (税込)	
会員企業*2	通常	385,000円 (税込)
	早期	360,800円 (税込)
	20小間以上	338,250円 (税込)

\*1 対象：非会員企業（一部適用外があります。）

\*2 対象：JPCA会員 / JIEP賛助会員 / JEP・TEP正会員

※1小間のサイズは、3m×3m=9m<sup>2</sup>です。

※小間設営・装飾費、電気・給排水、小間内清掃費、廃棄物処理費などの工事費および使用料は含まれていません。

## ■ 出展申込

展示会ウェブサイトよりオンラインでお申込みください。(www.jpccashow.com)

出展申込書を使用する場合は、メールもしくはFAXでお申込ください。

貴社の出展製品・技術・サービスに応じて、ご出展構成展をお選び頂き、必ず、出展申込書裏面の「出展規約」をご確認ください。

専用の出展申込書が用意されている展示会については、当該の出展規約が適用されます。

出展申込書を受理後、請求書を発行しますので、記載の期日までにお振込みをお願いします（原則会期前振込）。請求書は出展者専用webよりダウンロードをお願いします。

## ■ 申込締切

早期申込締切日	2021年7月 2日 (金)
早期申込締切日 ※2020年申込の会員・非会員企業	2021年7月20日 (火)
最終申込締切	2021年7月20日 (火)

※早期料金・対象については出展料の欄をご確認ください。

※予定の小間数に達した場合、締切らせて頂きます事を予めご了承ください。

## ■ 取消料

出展申込者の都合により出展を取り消す場合（全てまたは一部）下記の通り取消料を申し受けます。

書面による取消通知を受理した日	取消料
～7月20日 (火)	小間料金の 30%
7月21日 (水)～8月23日 (月)	小間料金の 50%
8月24日 (火)～9月23日 (木)	小間料金の 70%
9月24日 (金)～	小間料金の100%

## ■ 開催までのスケジュール

6月	7月	8月	9月	10月
▲ 6月上旬 出展申込受付開始	▲ 7月2日 (金) 出展早期申込締切  ▲ 7月20日 (火) 出展最終申込締切	▲ 8月中旬 出展者説明会 (予定)	▲ 9月上旬 招待状配布 来場登録開始	10月25日 (月)～26日 (火) 搬入期間  10月27日 (水)～29日 (金) 展示会開催  ※最終日即日撤去
← 8月下旬～随時 各種提出書類期限 →				

※小間位置の発表は、出展説明会当日とさせていただきますのでご了承ください。

### ●主催者による安全対策・対応方針について

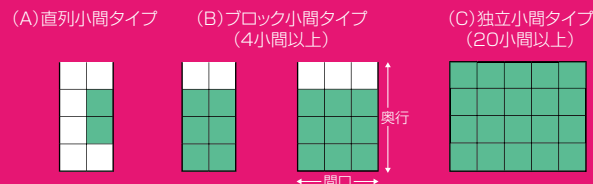
当展では参加者および主催、関係者の新型コロナウイルス感染拡大低減の対策を行い、展示会の安全性に配慮し、開催いたします。

今後は、政府や関係省庁、自治体の方針や要請を考慮し、施設との協議、連携のうえ計画を推進いたします。

### ●万が一の開催中止対応

新型コロナ (COVID-19) を要因として展示会の中止が決定した場合、出展料は100%返金します。※詳細は出展規約をご確認ください。

## ■ 小間形態



※小間タイプのご希望に添い加える場合もありますので、予めご了承ください。

※角小間のご希望は承っておりませんので、予めご了承ください。

## ■ 出展者サポートプログラム 有料・オプション

バーコードリーダーサービス、各種広告プラン等 出展の効果を高めるプログラムをご用意します。

※詳細は別途出展者説明会でご案内いたします。

## ■ パッケージブースプランのご案内

### ●1小間ベーシックプラン

価格：¥82,500 (税込)

最低限必要なブース造作、電源、カーペットなどが付属したプランです。



本部事務局

一般社団法人 日本電子回路工業会

〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2 回路会館2階

TEL : 03-5310-2020 FAX : 03-5310-2021 E-mail : show@jpcca.org

運営事務局

株式会社 JTBコミュニケーションデザイン

〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング

TEL : 03-5657-0767 FAX : 03-5657-0645 E-mail : jpcashow@jtbcom.co.jp



展示会公式サイトへ